

役立つ!ものづくり基盤技術・交流セミナー (第 4 回)

フレキシブル・ウェアラブルデバイスの最新動向

主催: MOBIO (ものづくりビジネスセンター大阪)、地方独立行政法人大阪産業技術研究所

開催日 平成31年 **1/24 (木)**
 時間 **18:00~19:30** (セミナー) **19:30~20:30** (交流会)
 場所 **クリエイション・コア東大阪** 北館3階 309号室

東大阪市荒本北1-4-17 (近鉄けいはんな線「荒本駅」下車5分)

講師: (地独)大阪産業技術研究所
 融合研究チーム リーダー, 研究管理主幹 **宇野 真由美**



近年、IoT(Internet of Things)社会といわれるように、あらゆるものにセンサを搭載し、そのデータを利用する技術が進展しています。インフラ管理や製造現場の効率化、予防医療、生体計測などの非常に幅広い分野で、センシングを利用した新しい取組みが提案されており、フレキシブル・ウェアラブルなデバイスの必要性が高まっています。本セミナーでは、これらの柔軟なデバイスの最新の技術動向について、材料・デバイス開発の観点から紹介するとともに、大阪技術研で開発したフレキシブルセンサやプロセス技術についても紹介いたします。

講演は、基礎的な内容から最近の話題までお話ししますので、企業の製造現場の方、研究開発、営業技術、経営者に至るまで、幅広い方を対象としています。講師は交流会にも参加しますので人的ネットワークづくりにもお役立て下さい。

参加費無料 (交流会は 1,000 円)

定員 30 名 (先着順)

ものづくり中小企業、支援機関
お申込み

「インターネット」または「FAX (下記の申込書に記載)」

※インターネットは、問合せ先のホームページにアクセスしてください。
お問合せ先

ものづくりビジネスセンター大阪 (松尾・小川) TEL: 06 (6748) 1052

CHECK!

から「MOBIO Cafe 開催案内」をご覧ください。

<http://www.m-osaka.com>

参加申込書

FAX 06-6748-1062 ※お一人ずつお申し込みください。切り取らずこのままFAXして下さい。

参加者氏名		企業名 部署・役職	
電話番号		FAX番号	
E-Mail			
住所	〒		
交流会	<input type="checkbox"/> 参加する <input type="checkbox"/> 参加しない		

※ 交流会は 19:30 より、南館 2 階テラスにて立食・軽食スタイルで開催します。(会費 1,000 円)
※ 本講習会参加申込みにかかる個人情報、主催者間で共有させていただきます。また、本申込書にご記入いただいた情報は、本講習会の参加者集計、その他催事情報提供などの案内を行う目的のみに使用します。